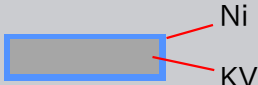
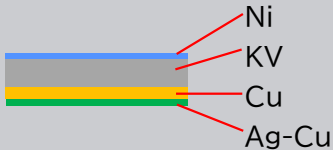
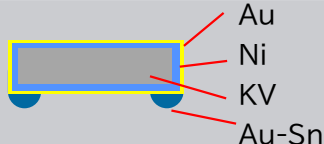
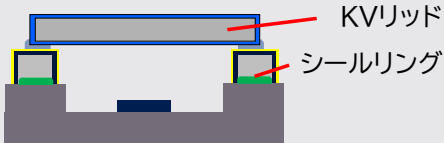
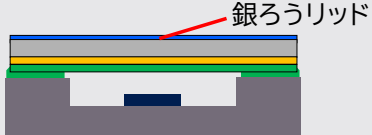
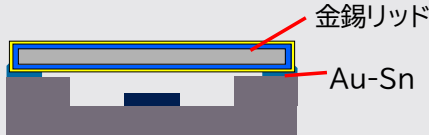


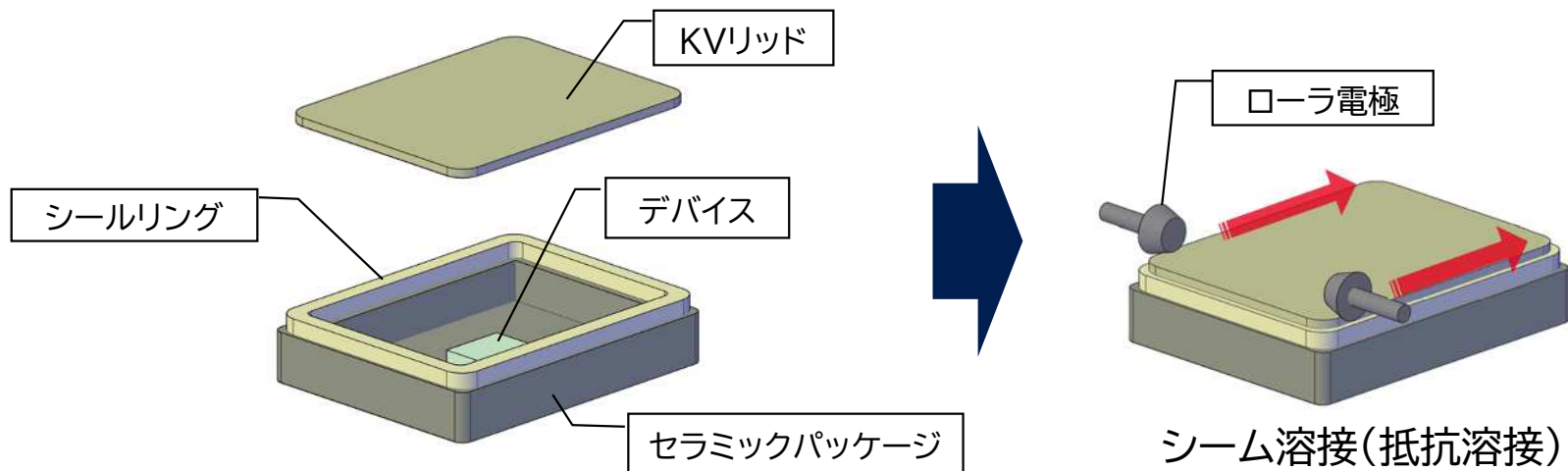
パッケージ気密封止用部材

1. SMD用リッドの種類

リッドの種類	KVリッド	銀ろうリッド	金錫リッド
材料構成			
デバイス構造			
封止方式	シーム溶接(シールリング有)	シーム溶接(シールリング無し)	リフロー炉
特徴	シールリング付きパッケージ使用 封止温度:1450℃程度	シールリング不要な為低背化可能 封止温度:780℃程度	シールリング不要な為低背化可能 封止温度:280℃程度 金を使用している為高価
当社のストロングポイント	素材から個片まで生産可能 品質安定・安定調達		特許取得のレーザートリミング 技術による金錫量の適正化

2. KVリッド

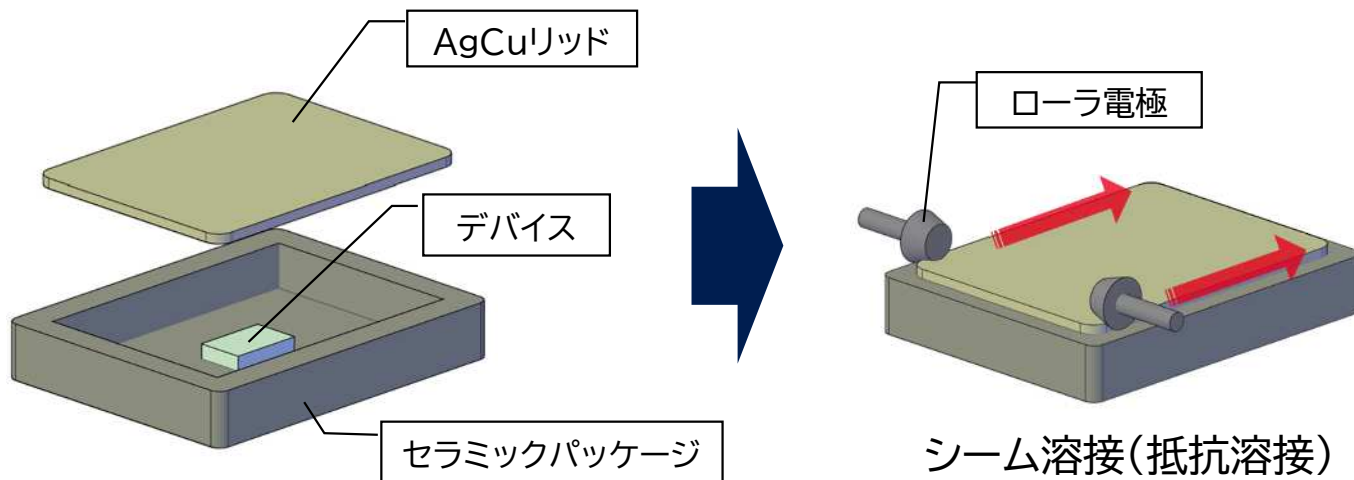
- ✓ KV(Fe-Ni-Co合金)の個片にNiめっきを施しているリッド
- ✓ シールリング(封止金具)付きのパッケージにシーム溶接で封止する際に使用



シールリング		KVリッド	
↑リッド側 KV (Fe-Ni-Co合金) クラッド AgCu ↓セラミックパッケージ側		KV (Fe-Ni-Co合金) Niめっき	

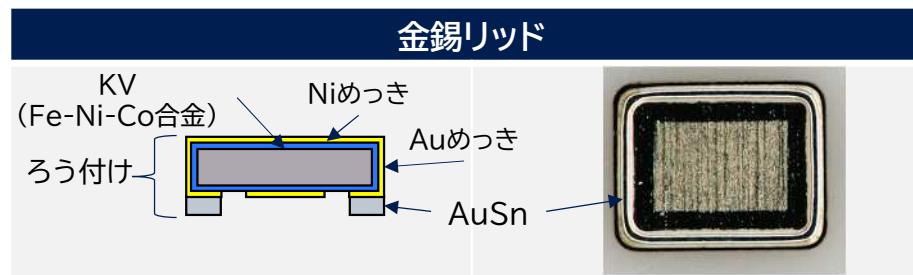
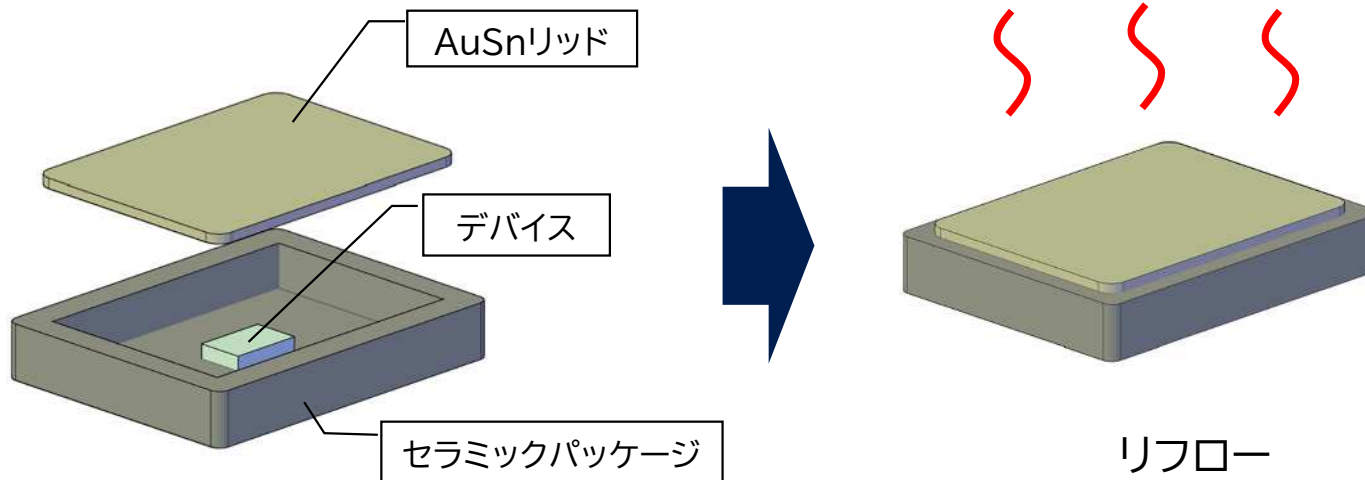
3. 銀ろうリッド

- ✓ Ni/KV/Cu/AgCuをクラッドした素材を個片加工したリッド
- ✓ セラミックパッケージに直接シーム溶接することが可能で、低背化と部材コストを抑えることが可能



4. 金錫リッド

- ✓ KV(Fe-Ni-Co合金)の個片にNiめっき、Auめっきを施し、AuSnをろう付けしたリッド
- ✓ 低融点で封止が可能の為封止性が良く、小型化かつ高品質が求められる製品に最適



4. 金錫リッド

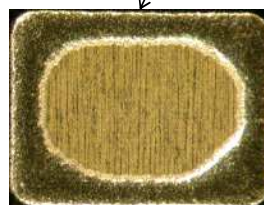
<レーザートリミング技術紹介>

・トリミングの効果

・トリミング無



金錫ろう材

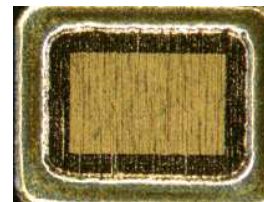


金錫流れ込み

・トリミング有



トリミング (Au除去+Ni酸化)

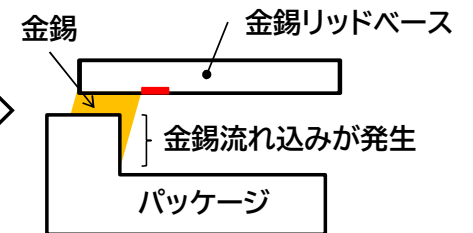


金錫流れ込み抑制

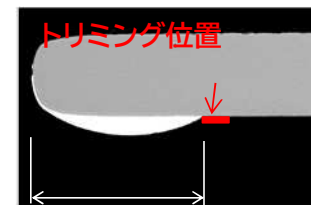
・トリミングによるパッケージ封止時の金錫流れ込み防止



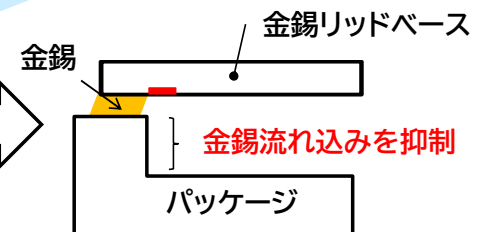
封止



トリミングによる金錫位置適正化



封止



- ・高価な材料である金錫ろう材のボリューム低減が可能。
- ・金錫ろう材のパッケージ内への流れ込み抑制により特性の安定化が可能。

PROTERIAL
